

2019年3月期 第3四半期決算ハイライト

2019年3月14日
住友精密工業株式会社

第3四半期実績



	(億円)			<参考>	
	2018年 3月期 第3四半期	2019年 3月期 第3四半期	差異	2018年 3月期 通期実績	差異
売上高	323	335	12	472	-
経常利益	7.9	19.1	11.2	20.5	-
特別損益	-	-52.0	-52.0	-6.1	-
(内、防衛装備品関連損失)	(-)	(-50.6)	(-50.6)	(-)	-
四半期純損益	3.1	-24.9	-28.0	5.0	-
総資産	791	808	-	801	7
純資産	332	301	-	336	-35
自己資本比率	40.7%	35.9%	-	40.6%	-4.7%

特別損失： 当第3四半期において、防衛装備品関連損失引当金として▲50.6億円を計上。

特別損失を： 第3四半期累計期間では、前年同期に対し、熱交換器およびMEMS・半導体用
除く業績 製造装置の増加等により、好転。

自己資本比率： 4.7ポイント低下し35.9%。

	(億円)			<参考>	
	2018年 3月期 通期実績	2019年 3月期 通期予想	差異	2019年 3月期 前回予想	差異
売上高	472	495	23	485	10
経常利益	20.5	23.0	2.5	10.0	13.0
特別損益	-6.1	-52.0	-45.9	-0.3	-51.7
(内、防衛装備品関連損失)	(-)	(-50.6)	(-50.6)	(-)	(-50.6)
当期純損益	5.0	-25.0	-30.0	4.5	-29.5
総資産	801	795	-6	795	0
純資産	336	301	-35	338	-37
自己資本比率	40.6%	36.5%	-4.1%	41.1%	-4.6%
配当	通期5円	上 2.5円、下 未定		上 2.5円、下 25円	

特別損失を： 2018年度通期の経常利益は、熱交換器およびMEMS・半導体製造用装置の増加
除く業績 により対前年度好転の見込み。前回予想に対しては、MEMS・半導体用製造装置の
販売増加および航空機用熱交換器／開発費の見直し等により、好転の見込み。

配当予想： 2018年度下期の配当予想は、25円（予定）としておりましたが、今次業績予想の
修正を踏まえ、未定とさせていただきます。

来期の業績予想等を踏まえ、決定次第、改めてお知らせいたします。